

ISS Europe 2005: Internationale Konferenz der Halbleiterbranche in Berlin

Europa in guter Ausgangsposition

Die Halbleiterindustrie in Europa hat über die letzten 15 Jahre kräftig aufgeholt. Was Innovationskraft, gut ausgebildete Ingenieure und die Kooperation untereinander auf vorwettbewerblicher Ebene betrifft, sind die Europäer sogar Vorbilder. Nur an einem mangelt's immer noch: An der Umsetzung der Innovationen in Produkte.

Berlin – »Es besteht überhaupt kein Grund, ängstlich zu sein, die europäische Halbleiterindustrie steht besser da als je zuvor«, sagte Arthur van der Poel, Chairman von MEDEA+, auf der ISS Europe 2005 in Berlin.

Dennoch gibt es Entwicklungen, die beachtet werden sollten: Erstens ist die Wachstumsrate im IC-Markt niedriger als in den 80ern und Anfang der 90er-Jahre: Zwischen 1993 und 2003 betrug sie jährlich nur 8 %, zwischen 2003 und 2013 soll sie bei 10 % liegen.

Zweitens wandert die Fertigung elektronischer Geräte ostwärts, von 2001 bis 2005 wächst sie allein in China mit einer Durchschnitts-Jahresrate von 24 % auf 14 % des Weltmarktes in Höhe von geschätzten 1112 Mrd. Dollar. Und China bildet deutlich mehr Ingenieure pro Jahr aus als die EU. Doch Europa hat auch Vorteile im künftigen Wettbewerb der Halbleiterindustrie: Drei Europäer

Arthur van der Poel, MEDEA+: »Europas Halbleiterindustrie steht besser da als je zuvor.«



Multisim und LabVIEW verknüpft
NI übernimmt Electronics

Thema der Woche

► Seite 20

Polymer-elektronik

Klein, leicht und noch dazu wert: Kunststoffe, die Strom leiten oder leuchten, sollen die Zukunft allgegenwärtiger Elektronikbranche versprechen. Umsätze in Milliardenhöhe.

► Seite 16

Interview der Woche



Als Co-Senior-Präsident der Infineon-Gruppe hat er reichlich Erfahrungen gesammelt.

Europa in guter ...

sind unter den Top Ten der IC-Hersteller – ein Beweis dafür, dass Jessi und die Nachfolgeprogramme gegriffen haben. Die Erfolgsgeschichte von ASM Lithografie hat gezeigt, dass europäische Unternehmen sogar in der amerikanischen und japanisch dominierten Equipment-Industrie erfolgreich sein können. Der industriellen Sektor, die Telekommunikation und die Automobilindustrie sind Beispiele für die Stärken Europas.

Was dem Erfolg zugrundeliegt, ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die sich in der Bildung von Clustern niedergeschlagen hat: Unter anderen gehört Dresden dazu, ebenso wie Nijmegen/Eindhoven/Leuven (IMEC), Crolles/Grenoble (LETI) und Catania. MEDEA + hat 300 Partner in 16 europäischen Staaten. »Auf der EU-Ebene können wir dazu beitragen, dass die Cluster in den Regionen voneinander lernen und dass sie sich vernetzen. Wir müssen dazu beitragen, dass alle an einem Strang ziehen«, sagt David White, Director for Innovation Policy der EU. Van der Poel stimmt dem zu: »Die europäischen Firmen haben das Problem in einen Vorteil verwandelt. Sie haben gelernt, mit komplexen Prozessen umzugehen, kulturelle und sprachliche Barrieren zu überbrücken und sind sehr gut auf der Ebene der vorwettbewerblichen Zusammenarbeit.« Deshalb sei die europäische Industrie sehr gut auf die künftigen Herausforderungen vorbereitet: vielleicht weniger darin, immer komplexere ICs mit noch kleineren Strukturen zu entwickeln (»More Moore«), sondern eher darin, in neue Technologien wie MEMS vorzustoßen (»More than Moore«). Das glaubt auch Dr. Reinhard Ploss, COO AIM von Infineon Technologie. Er weist auf die wachsende Bedeutung der Analogtechnik hin (»Bei hohen Taktfrequenzen verhält sich auch Digital wie Analog, das kommt Europa entgegen) und sieht Europa vor allen als ein Zentrum der IP-Entwicklung. Hier setzt auch Kees den Otter an. Der President von TSMC Europe ist überzeugt davon, dass die Sym-

biose zwischen IDMs, fabless Companies und Foundries die Wettbewerbsfähigkeit Europas deutlich verbessern könne.

Ein Problem von Europa besteht darin, dass es immer noch nicht gelungen ist, die Brücke von der Innovation – hier war Europa nie wirklich schlecht – zum erfolgreichen Produkt zu schlagen. Zwar gibt es Lichtblicke wie GSM, die Regel scheint aber doch zu sein, dass europäische Innovationen in anderen Regionen umgesetzt werden, siehe MP3. Professor Dr. Herbert Reichl glaubt aber schon, dass Europa (und Deutschland) auf diesem Gebiet aufholen konnte: »Schauen Sie nur die Vielzahl der Spin-offs aus den Instituten an. Die Forschung ist heute sehr viel stärker auf Produkte konzentriert, da hat sich doch sehr viel geändert.« Allerdings stimmt auch er zu, dass hier noch mehr getan werden könnte, die Unternehmen sollten die Forschung in den Instituten mehr beachten.

»Wir sind einfach eine immer noch zu problemorientierte Gesellschaft«, sagt Walter Roessger, President SEMI Europe/CIS. Während seiner Tätigkeit in der Forschung in den USA habe er vor allem eines gelernt: Lösungen zu bieten, anstatt Probleme zu dis-

kutieren. Kein geringerer als David Wang, Executive VP von Applied Materials, macht den Europäern Mut: Europäische Marken, ob Autos oder Consumer-Produkte, seien in China beliebt, sowohl Europa als auch China könnten auf eine lange Geschichte zurückblicken, was den Umgang miteinander vereinfache, und er stimmt mit der These überein, dass die

Anzeige



Europäer sehr gut mit komplexen Problemen umgehen könnten, seien sie technischer oder juristischer Natur. Aber er scheut sich auch nicht, auf Schwachstellen hinzuweisen: »Innovationen sind gar nichts, solange die Kommerzialisierung nicht gelingt.« (ha) ■

Nur noch ...

Ähnliche Erwartungen bestehn auch bei weltweiten Wachstumstrends, wobei in Europa in jüngerer Zeit eine bessere Entwicklung als in allen anderen Regionen verzeichnet wurde. Jedoch dürfe die Unwägbarkeiten durch Einfüsse des wieder stärker gewendeten Dollars nicht übersehen werden. (st)

NI übernimmt ...

Hierzu bietet NI unter der Internetadresse www.ni.com/design/eda.htm kostenlose LabVIEW-V (virtuelle Instrumente) an, die es erlauben, SPICE-Dateien von Multisim in LabVIEW zu übertragen.

»Viele unserer Kunden klagen, dass Design-, Simulations- und Test-Tools immer noch zu stark voneinander getrennt seien«, erläutert Ray Almgren, Vice President of Product Marketing at Academic Relations von NI. »Wir wollen das ändern, indem wir die beiden grafisch orientierten Programmpakete Multisim und LabVIEW zusammenführen, um eine nahtlos integrierte grafische Systemdesign-Plattform zu schaffen.« (ak)

Neuer Eigentümer für Covion Organic Semiconductors

Merck übernimmt OLEDs und Polymerelektronik von Avecia

Darmstadt – Merck übernimmt von Avecia das Geschäft mit organischen Licht emittierenden Materialien (OLEDs) sowie Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der Polymerelektronik zu einem Kaufpreis von 50 Mio. Euro in bar. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden und soll im ersten Quartal 2005 abgeschlossen sein.

Kern der Transaktion ist das Frankfurter Unternehmen Covion Organic Semiconductors. Covion zählt in der Forschung, Entwicklung und Herstellung von OLED-Materialien zu den weltweit führenden Unternehmen und erzielte

im Jahr 2004 einen Umsatz von rund 8 Mio. Euro. Das Unternehmen geht auf ein Projekt der früheren Zentralforschung von Hoechst zurück und wurde 1999 als Joint-Venture von Aventis Research & Technologies und Avecia etabliert. Seit 2002 befindet sich Covion im alleinigen Besitz von Avecia.

Außerdem erwirbt Merck von Avecia eine Forschungs- und Entwicklungseinheit auf dem Gebiet der Polymerelektronik, die in Manchester angesiedelt ist. Nach Abschluss der Transaktion werden beide Aktivitäten mit insgesamt rund 100 Mitarbeitern zu Merck wechseln und dort in die Unter-

nehmenssparte Flüssigkristalle integriert. In diesem Bereich werden auch neuartige Materialien entwickelt. »Flüssigkristall-Displays in den nächsten Jahren auf dem Flachbildschirm-Markt dominieren«, so Prof. Dr. Bernhard Bernhardt, Vorsitzender der Geschäftsbereichsgruppe der Forschung von Merck, »doch wird auch das Potenzial alter Technologien frühzeitig genutzt.« Bereits im Dezember hat Merck ein OLED-Forschungsprojekt von Schott übernommen. Auf dem Gebiet der Polymerelektronik verfügt Merck über ein eigenes Forschungszentrum in Basingstoke, UK. (su)